

日時

2025年7月4日(金)

13:00-17:00

場所

岩手大学地域協創推進棟 2階セミナー室
(207室) およびオンライン (Zoom)

半導体基板に関するセミナー

岩手大学分子接合技術研究センターでは、分子接合技術 (i-SB法) と機能樹脂設計技術を基盤とする i-SB事業化プラットフォームを設立し、ものづくり分野で新たなプロセスやプロダクトのイノベーションを創出することを目指しています。

このたび、当センターでは、半導体基板に関するセミナーを開催します。

◆参加費：10,000円

(消費税込・資料付き)

◆申込：

下記URLまたはQRコードを読み込んで
お申し込み下さい。

<https://forms.gle/soQ9pgNpjWqHrAEK7>

申込期限

6月27日(金)



◆セミナー終了後 5～6営業日をめぐに参加費の請求書をメールでお送りします。
請求書に記載の期限までに、参加費のお振り込みをお願いします。

◆Zoomでの参加者には、6月30日以降に、ミーティングリンクを送付します。

◆講演会場は【岩手大学キャンパスマップのA17】です (理工学部正門から徒歩2分程度)。

◆プログラム：

1

半導体パッケージの基礎から最新まで (90分)

Amkor Technology Japan, Inc. R&D Center
馬場 伸治 氏

2

高周波絶縁材料の紹介
～低誘電シリカおよび低誘電マクロモノマー
(商品名SNECTON) を中心に～ (60分)

デンカ株式会社 電子・先端プロダクト部門事業推進部
荒井 亨 氏

3

溶媒可溶性シクロオレフィンポリマー
(商品名COPLUS) について (60分)

住友ベークライト株式会社 HPP技術開発研究所
穴田 亘平 氏

主催：岩手大学分子接合技術研究センター

共催：i-SB事業化プラットフォーム

(運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター)

東北ポリマー懇話会、INSポリマー研究会

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局 (岩手大学 研究・地域連携課)



isb-office@iwate-u.ac.jp



<https://mbt.ccrd.iwate-u.ac.jp/>